

ソリューションセリング

※赤文字は
新規or
追加項目

基板設計 Engineering




基板設計

- ◆片面・両面4~10層
- ◆インパダンスコントロール
- ◆差動・等長・DDR3配線
- ◆シミュレーション技術対応
- ◆実装設計反映

CR5000 BD(国研)

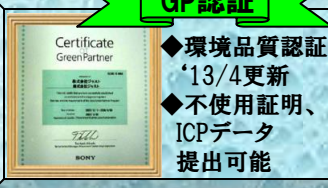
資材 Procurement



資材

- ◆CR(E24系列) 自社在庫
- ◆各種部品調達・管理
- ◆各種基板製作 (VA提案&短納期)
- ◆部品取り・検品・管理
- ◆基板・BGAのペーキング&防湿保管管理

GP認証



GP認証

- ◆環境品質認証 '13/4更新
- ◆不使用証明、ICPデータ提出可能

Mount

はんだ印刷



YCP10 (ヤマハ)

- ◆0402~0.3mmCSP
- ◆CCDカメラによる一括認識/補正
- ◆メタルスキージ
- ◆2段版離れ機構

部品装着



YS12F (ヤマハ)

- ◆0402~□31mmCSP
- ◆搭載精度±50μm
- ◆90品種対応可能
- ◆シングルトレイによる異形部品対応

部品装着



YV100X (ヤマハ)

- ◆0603~□32mmBGA
- ◆BGA全ホール認識可能
- ◆レーザー認識によるリード浮き検出
- ◆50段トレイによる異形部品対応

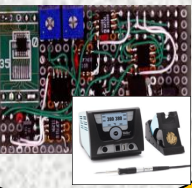
リフロー炉



A30-82 (エイテック)

- ◆無鉛はんだ対応
- ◆8+2ゾーンによる最適プロファイル

手付・修正



手付・修正

- ◆社内資格制度
- ◆熱量貯蓄、効率良い熱伝導コテ先
- ◆ユニバーサル対応
- ◆1点からの手付対応


画像検査



U22XHML (マランツ)

- ◆200万画素カメラ
- ◆テレセントリックレンズ
- ◆三色照明
- ◆同軸落射照明

DIP槽



SPF2-400 (千住)

- ◆特殊ノズルによるフラックス塗布
- ◆整圧フロー方式高品質はんだ付け
- ◆整流版レスによる酸化物付着低減

X線検査



FX-300tR (iBIT)

- ◆最大倍率900倍
- ◆60°傾斜観察によるオープン、クラック検出可能

1日実装対応可能

Engineering


信頼性評価



NEXIV (ニコン)

- ◆定量的な実装評価
- ◆コプラナリティ、平坦度
- ◆鳥瞰図出力解析
- ◆はんだ濡れ性試験
- ◆はんだ付け信頼性試験
- ◆ピール強度試験

試作・量産DR



- ◆実装カルテ
- ◆試作DR
- ◆未然防止の提案
- ◆量産へのDR品質・生産性

EMC



- ◆不要電磁波妨害試験
- ◆免疫試験
- ◆PSEマーク/Ceマークの取得サポート
- ◆試験機器校正サービス

Production

組立・調整



- ◆筐体への組立完成~調整検査まで対応
- ◆治工具導入、ボカヨケ

ハーネス加工



- ◆IF・フラットケーブル加工
- ◆絶縁耐圧検査まで
- ◆原線から各種圧接加工

各種リワーク



RD-500V (デンオン)

- ◆各種BGAリワーク
- ◆部品交換、改造対応